

ATRON® AC 205

スプレー式洗浄装置用水系フラックス除去洗浄剤



ATRON® AC 205 はアセンブリ基板からフラックス残渣を除去するため設計された FAST®テクノロジー系の洗浄剤です。ATRON® AC 205 をはじめとする FAST® テクノロジーの洗浄剤は大幅に高められた特性を持つ新世代の界面活性剤を基にしています。従来活性剤を基にした洗浄剤と比較すると、ATRON® AC 205 はより短い処理時間と非常に長い洗浄剤ライフを提供いたします。従って ATRON® AC 205 は特に短い処理時間が要求される高圧インライン洗浄装置に最適です。

適用領域: PCB 洗浄		製品補足情報:
低固形成分フラックス残渣	++	Technical Information 2: 洗浄テスト済みのフラックス及びはんだペースト資料
ロジン系フラックス残渣	++	
水溶性フラックス残渣	++	Technical Information 3: 材料適合性資料
はんだペースト(未はんだ)	+	FAST® テクノロジー: FAST® テクノロジー詳細情報

++ 優、最適 + 良 0 可 - 不可

テクニカルセンター ①アメリカ ②ヨーロッパ ③ マレーシア ④中国華東 ⑤ 中国華南 生産現場条件下での洗浄プロセスソリューション



無料洗浄テストをご希望の方は、下記 ZESTRON プロセス技術チームまでご連絡下さい。
電話: 0463-79-6756; Email: infojapan@zestron.com

他社界面活性剤ベース洗浄剤と比較しての利点:

- エタノールアミン他の有害物質が含まれておりません。
- 幅広く最新鉛フリー及び共晶はんだフラックス残渣のより素早い除去が可能です。
- 従来の界面活性剤ベース洗浄剤と比較して長い液寿命を持ちます。
- 穏やかな組成のためはんだ付け部やパッドの外観を保ちます。
- アルミ及びエポキシ樹脂表面への優れた材料適合性のため特別調合されました。
- 低臭気です。
- 非常に低い VOC 値です。

プラスチック部材を洗浄する前に材料適合性資料 (Technical Information 3) をご参照下さい。

工程	1. 洗浄	2. リンス	3. 乾燥
スプレー (インライン)	ATRON® AC 205	精製水 (40°C)	熱/循環風
スプレー (バッチ)	ATRON® AC 205	精製水 (40°C)	熱/循環風

技術情報

下記の情報は ATRON® AC 205 の 10% 濃度でのものとご留意下さい。

比重	g/ccm at 20°C	1.00
表面張力	mN/m at 25°C	28.9
沸点範囲	°C	> 100
引火点	°C	なし
pH 値	10g/l H ₂ O	10.4
洗浄温度	°C	40 - 70
適用濃度 ¹ (インライン)	%	5 - 15
適用濃度 ¹ (バッチ)	%	15 - 30
HMS 情報	健康障害 - 引火性 - 反応性	1 - 0 - 0

¹ ATRON® AC 205 は精製水にて希釈する必要があります。

製品特性



鉛フリーはんだペースト洗浄を幅広く試験し適合を確認しております。



FAST® テクノロジーにより部品の下部のフラックス残渣であっても素早く取り除くことを保証いたします。



EU 基準 (RoHS 1 & 2, WEEE) に 100% 適合しております。



SIN, SVHC リストに従い、高懸念物質は使用しておりません。

環境、健康、及び安全に関する規制:

- ATRON® AC 205 は水系で生分解性です。
- 取扱いに関する注意事項は MSDS をご参照ください。

荷姿、保管について

- ATRON® AC 205 は 1L 瓶、5L・25L の容器及び 200L ドラム缶にてご用意させていただいております。
- 本製品は危険物です。
- ATRON® AC 205 は 5 - 30°C の範囲で元の容器に入れて保管してください。
- 製品寿命は未開封状態で 5 年です。

推奨代替製品:

- ハイエンド製品のフラックス除去及びクローズド工程の要求であれば、MPC® テクノロジー系の製品を推奨します。低水圧バッチ洗浄であれば VIGON® A 250、中・高水圧インライン洗浄であれば VIGON® A 201 を推奨いたします。